

Products

プリント基板用リレー

DC大容量リレー(形G9E シリーズ)

車載用リレー

ソリッドステート・リレー

スイッチ

コネクタ

機器組み込みセンサ

マイクロセンシングデバイス

光通信デバイス

液晶用バックライト

MEMS / IC

New Products

New Technology

Electronics Mail申し込み



PDFをご覧いただくにはAcrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページからダウンロードしてください。

Micro Sensing Device
マイクロセンシングデバイス



商品特長

フォト・マイクロセンサ[透過形]
形EE-SV3シリーズ

定格
性能

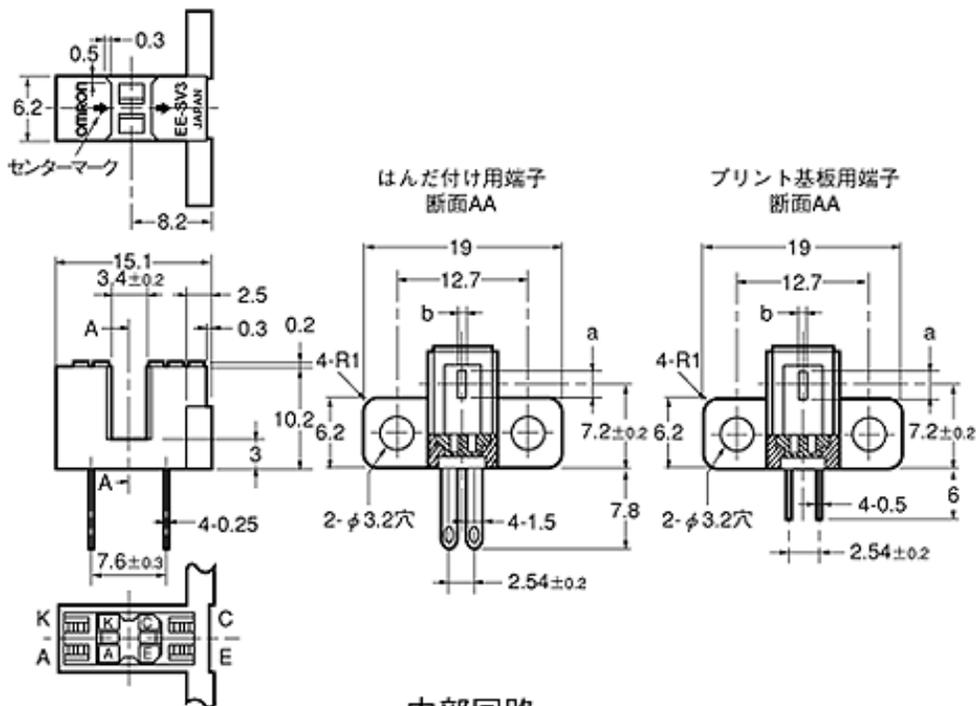
外形
寸法

スリット幅0.2mm,0.5mmの高分解能タイプから
1mmの高感度タイプと横スリットタイプを用意
はんだ付け用端子タイプ
EE-SV3/-SV3-CS/-SV3-DS/-SV3-GS
プリント基板用端子タイプ
EE-SV3-B/-SV3-C/-SV3-D/-SV3-G



外形寸法

(単位:mm)



形式	スリット穴(a×b)
形EE-SV3	2.1×0.5

形EE-SV3-CS	2.1 × 1.0
形EE-SV3-DS	2.1 × 0.2
形EE-SV3-GS	0.5 × 2.1

形式	スリット穴 (a × b)
形EE-SV3-B	2.1 × 0.5
形EE-SV3-C	2.1 × 1.0
形EE-SV3-D	2.1 × 0.2
形EE-SV3-G	0.5 × 2.1

端子記号	名称
A	アノード
K	カソード
C	コレクタ
E	エミッタ

指定なき寸法公差は下表とする。

寸法区分	公差
3以下	± 0.2
3を越え6以下	± 0.24
6を越え10以下	± 0.29
10を越え18以下	± 0.35
18を越え30以下	± 0.42



WWW.OMRON.CO.JP